



WS735



Flux soluble en agua

Características:

- Fórmula sin salpicaduras
- Alta Actividad y Excelente Wetting
- Amplia Ventana de Proceso
- Residuos libres de espuma durante el proceso de lavado

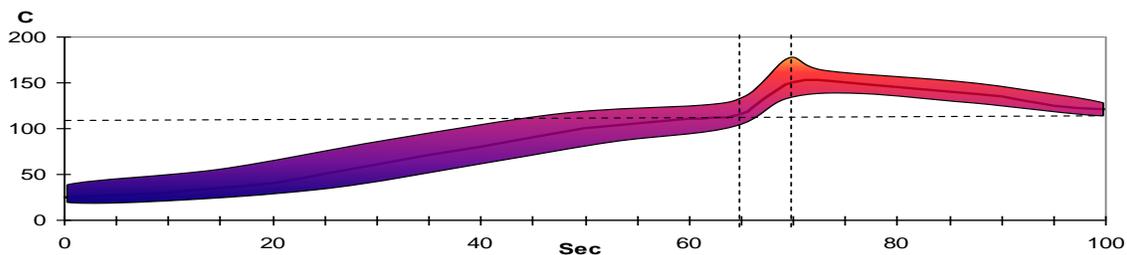
Descripción:

El WS735 es un flux líquido soluble en agua, con base de alcohol, activado orgánicamente, diseñado específicamente para aplicaciones de soldadura por ola. El WS735 puede ser aplicado mediante rociadores automatizados de flux, como espuma, inmersión o cepillado con resultados favorables. El WS735 permanece activo a temperatura ambiente y mantiene un amplio rango de activación y características de wetting excepcionales que producen uniones de soldadura brillantes. El WS 735 funciona muy bien con pwbs de cobre, recubiertos de soldadura y con recubrimiento orgánico. El WS735 puede ser utilizado con aleaciones estaño-plomo y libres de plomo. En virtud de que el flux WS 735 permanece activo después del proceso, todos los residuos deben ser eliminados de los PCBs.

Aplicación de Flux:

El WS735 puede ser utilizado como espuma, por rocío, cepillado, barrido entre otros. Para aplicarse por rocío, el WS735 está listo para ser utilizado directamente de su contenedor, sin requerir dilución. Al aplicar el flux por rocío, es imperativo que se logre y mantenga una cobertura y uniformidad adecuadas. Se recomienda una capa de flux seco de 500 a 1500 microgramos por pulgada cuadrada, como punto de partida. Si fuese necesario diluirlo, deberá utilizarse el Thiner AIM 735.

Perfil Térmico Típico:



RAMPA DE PRECALENTAMIENTO 2-3 °C / SEC MAX	PROGRESO A TRAVÉS DE 66°C - 77°C (150 - 170°F) ≤ 40 SEGUNDOS	TEMPERATURA DEL LADO SUPERIOR DEL PCB 87°C - 115°C (190°F - 240°F) JUSTO ANTES DE LA OLA	ENFRIAMIENTO ≤ 4°C
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Limpieza:

Los residuos y el flux crudo son completamente solubles en agua y deben lavarse en un sistema de limpieza acuosa utilizando agua desionizada o destilada caliente a una temperatura recomendada de al menos 60°C .

Manejo y Almacenaje:

- El WS735 tiene una vida, en empaque cerrado, de un año cuando se almacena a temperatura ambiente. No se congele este producto.
- El WS735 está listo para usarse, no es necesario realizar ninguna mezcla.
- No mezcle químico usado con nuevo en el mismo contenedor. Vuelva a sellar cualquier contenedor abierto.

Seguridad:

- Utilícese en un área debidamente ventilada y con equipo protector personal adecuado.
- Para información específica de emergencia, refierase a la Hoja de Datos de Seguridad de Material anexa.
- No desechar material peligroso en contenedores no autorizados.

Propiedades Físicas:

Parámetro	Valor
J-STD-004	ORH1
Visual	Claro, Incoloro
Olor	Aromático (Ligeramente)
Contenido de Sólidos	23.1 %

Parámetro	Valor
Gravedad Específica	.9979 ± 0.005 (agua = 1)
Punto de Inflamación	< 10°C
Punto de Ebullición	82°C
pH (1% solución/agua)	1.28

Prueba de Corrosión:

Parámetro	Requerimientos	Resultados
Espejo de Cobre (24 hrs @ 25°C, 50%RH)	IPC-TM-650-2.3.32	Alto
Prueba de Haluro(Cromato de Plata)	IPC-TM-650-2.2.33	Presencia de Haluros

Fábrica y Distribución en Todo el Mundo

USA +1-401-463-5605 · Canadá +1-514-494-2000 · Europa +44-1737-222-258 · México +52-656-630-0032 · Asia-Pacífico +86-755-2993-6487
info@aimsolder.com · www.aimsolder.com

AIM ESTA CERTIFICADA EN ISO 9001:2008 y ISO 14001: 2004

La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. Toda información sobre la soldadura en pasta es producida con polvo de 45 micrones. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms.cfm> para revisar términos y condiciones de AIM.